

中标结果公示

项目名称：半导体多芯片堆叠大尺寸封装基板产品制造项目厂房建设项目施工总承包
[项目编号：JG2025-5450]

定标时间：2025 年 12 月 30 日 13 时 30 分至 18 时 00 分

公示时间： 年 月 日

单位名称	总得分	排名	是否被确认为中标人
广西城建建设集团有限公司	67.01	10	否
中铁建设集团有限公司	88.24	2	否
中建三局第一建设工程有限责任公司	84.65	3	否
南宁市市政工程集团有限公司	68.01	7	否
中建四局建设发展有限公司	84.41	4	否
深圳市禾图建设有限公司	67.21	9	否
中铁十五局集团有限公司	82.75	5	否
中国机械工业建设集团有限公司	78.26	6	否
中建八局第三建设有限公司	92.39	1	是
深圳市精微建设工程有限公司	67.41	8	否
中标人：中建八局第三建设有限公司	中标价（万元）： 14710.085245		项目负责人：陈金松

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自公示之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当递交投诉书，投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（7 部委第 11 号令）第七条的规定。

招标投标监督部门：广州开发区建设工程招标投标管理办公室（广州市黄埔区建设工程招标投标管理办公室）、广州开发区行政审批局

联系地址：广州市黄埔区水西路 30 号四楼、广州市黄埔区香雪三路 3 号

联系电话：020-82181336、020-82118560

招标人名称：广州广芯封装基板有限公司

